

## 売上および利益

## 事業環境

当期2004年3月期の世界経済は、イラク情勢の緊迫化や期初におけるSARSの流行などの不安要因がありましたが、米国では減税の効果などにより好調な景気が持続しました。アジアでは中国が継続的に成長し、台湾や韓国においても回復基調となりました。日本においては、円高などの影響があったものの企業収益の改善が見られ、製造業を中心に設備投資や輸出が堅調に推移し、緩やかに回復しました。

当社の参画しているエレクトロニクス業界においては、PCやカメラ付き携帯電話の新機種への買い替え需要に加え、DVDレコーダー、デジタルカメラ、薄型テレビに代表されるデジタル家電の市場が拡大し、活況を呈しました。これを背景に、半導体産業においては日本を含むアジアに拠点を置く多くの半導体メーカーの設備稼働率が上昇し、特に当会計年度後半以降、製造能力の増強が図られました。

## 売上の状況

2004年3月期の連結売上高は、こうした環境のもと、2003年3月期比15.0%増加の5,297億円となりました。主力の半導体製造装置部門の売上高が、主に日本を含むアジアの半導体メーカーおよびFPD（フラット・パネル・ディスプレイ）メーカー向けに伸長したことにより、前期比16.7%増加の4,257億円となりました。コンピュ

ータ・ネットワーク部門および電子部品部門もそれぞれ堅調に推移しました。

地域別では、国内売上高が前期比27.2%増加の2,423億円、海外売上高が6.4%増加の2,873億円となりました。連結売上高に占める海外売上高の比率は前期の58.6%から54.2%に減少しました。

また、当期の連結受注高は、前期比42.5%上昇し6,536億円となり、期末の受注残高は前期比82.3%増加の2,747億円となりました。

## 部門別営業概況

## 半導体製造装置部門

ITバブルの崩壊を契機として、世界のエレクトロニクス産業、とりわけ半導体関連産業は約2年間にわたり、厳しい事業環境が継続しましたが、2003年に入ってからPCやカメラ付き携帯電話の買い替え需要が高まったことや、デジタル家電関連の市場が立ち上がってきたことにより、関連デバイスを製造する半導体メーカーの設備投資意欲が急回復しました。特にデジタルカメラで使用されるイメージセンサーやFPDの駆動用ICなどでは日本に強みがあり、春以降、国内の半導体メーカーからの受注が増加しました。その後、メモリやPC関連デバイスの需要増を受けて、アジアの半導体メーカーを中心とした設備投資が拡大しました。

単位：百万円（売上高に占める割合）

単位：千米ドル

	2004年	2003年	2002年	2004年
売上高	¥529,654 (100.0)	¥460,580 (100.0)	¥417,825 (100.0)	\$5,013,762
売上原価	389,499 (73.5)	326,540 (70.9)	302,270 (72.3)	3,687,037
売上総利益	140,155 (26.5)	134,040 (29.1)	115,555 (27.7)	1,326,725
販売費及び一般管理費	117,875 (22.3)	132,921 (28.9)	133,865 (32.0)	1,115,823
営業利益（損失）	22,280 (4.2)	1,119 (0.2)	(18,310) -	210,902
その他収益（費用）	(7,344) -	(24,129) -	(4,609) -	(69,520)
税金等調整前当期純利益（損失）	14,936 (2.8)	(23,010) -	(22,919) -	141,382
法人税等	6,124 (1.2)	18,532 (4.0)	(2,990) -	57,962
少数株主利益	515 (0.1)	12 (0.0)	8 (0.0)	4,876
当期純利益（損失）	8,297 (1.6)	(41,554) -	(19,938) -	78,544

この結果、2004年3月期の半導体製造装置部門の連結受注高は5,498億円と、前期に比べ51.3%増加しました。当部門の連結売上高は4,257億円と、前期比16.7%の増加となりました。当部門の連結売上高に占める割合は、前期の79.2%から80.4%へと増加しました。また、薄型テレビ市場の長期的な成長を見込み、国内外のパネルメーカーが新工場を建設するなど設備投資を増やした結果、当部門の売上高に含まれるFPD製造装置の売上高も前期と比べ増加しました。

売上高の地域別動向としては、デジタル家電用半導体デバイス向けに投資が活発であった日本は前期比45.7%増加の1,419億円、半導体メモリやFPD向け投資が増加した韓国は前期比7.2%増加の614億円と、いずれも大幅に増加しました。前期まで投資が低調であった台湾においても投資が再開され、前期比49.9%増加の1,005億円となりました。一方、米国への売上は主要半導体メーカーの設備投資意欲が継続して低調であったことにより、前期比31.9%減少の506億円となりました。

装置別動向としては、装置市場全体の拡大に伴い、コータ/デベロッパ、エッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉CVD装置、ウェーハプローバ、洗浄装置、FPD製造装置など全ての主要製品において売上が増加しました。新製品では、新型の熱処理成膜装置「TELFORMLA」、次世代対応のコータ/デベロッパ装置「CLEAN TRACK LITHIUS」

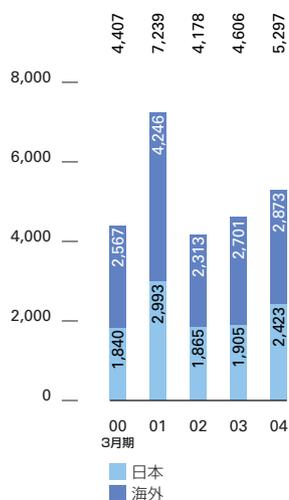
の販売を拡大しました。ウェーハ口径別では日本を含むアジアの半導体メーカーを中心に300mmウェーハ対応工場への投資が増えつつあり、装置本体の売上に占める300mm装置の比率としては60%程度まで上昇しました。

### コンピュータ・ネットワーク部門

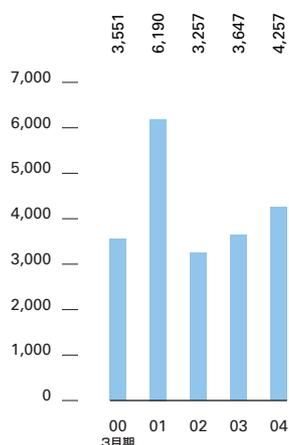
SAN (Storage Area Network : 外部記憶装置間および記憶装置とコンピュータの間を結ぶ高速なネットワーク) ソリューション、ネットワークソリューション、およびブロードバンドソリューションを提供するコンピュータ・ネットワーク部門の売上は、前期比7.3%増加の184億円となりました。

当部門の売上高の37%を占めるSAN関連製品では、Brocade社のファイバーチャネルファブリックスイッチやEmulex社のファイバーチャネル・ホストバスアダプタが順調に売上を伸ばしました。また、ストレージセキュリティの重要性に着目して取り扱いを開始したNeoScale Systems社のバックアップデータ暗号化製品は、データ漏洩防止のソリューションとして採用され始めています。今後は、オープン系テープオートメーション市場で世界No.1のマーケットシェアを有するADIC社 (Advanced Digital Information Corp.) のテープライブラリーの販売も開始し、データの保管・管理まで視野に入れたソリューションを提供していきます。

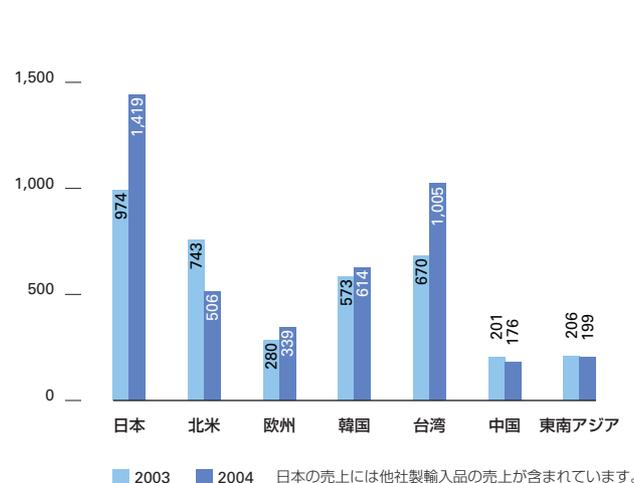
国内及び海外売上高  
(単位：億円)



半導体製造装置部門売上高  
(単位：億円)



半導体製造装置部門 地域別売上高  
(単位：億円)



ネットワーク関連製品では、当部門の主力製品のひとつであるF5 Networks社がSSL-VPN (Secure Sockets Layer-Virtual Private Network) 製品をラインナップに追加したことにより、売上を拡大しました。

自社開発の高精細映像・音声配信システム Ruff Systemsは、HDTV (High Definition Television : ハイビジョン) カメラに比べて安価なHDV (High Definition Video) 規格準拠のビデオカメラ映像を、インターネットプロトコルで伝送可能な「Ruff Systems HDV版」を新たに追加しました。ブロードバンドネットワークを利用したハイビジョン映像の伝送を可能にしたことで、今後プロフェッショナルユースからコンシューマーユースまで、HDTVコンテンツの普及に貢献できる可能性があると考えています。

### 電子部品部門

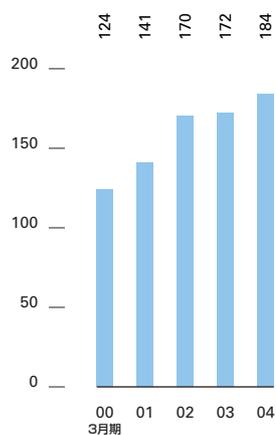
当期は、技術サポートを要する高付加価値商品の販売に注力するとともに、取扱商品の拡大、新規商品の採用促進に努めました。2003年10月には、長岡市と岡山市に営業拠点を開設するなど、顧客ニーズに沿った営業展開も行いました。この結果、「半導体製品」、「ボード製品」、「ソフトウェア」、「一般電子部品」を取扱う電子部品部門の当期連結売上高は、前年比8.9%増加の842億円となりました。

電子部品部門の売上高の88%を占める「半導体製品」においては、薄型テレビなど民生機器向けに用途を拡大しているザイリンクス社のPLD (プログラマブルロジックデバイス) や、主に携帯端末の電源用に使用されるリニアテクノロジー社の汎用アナログICなど高付加価値商品の拡販に努めました。また、2002年に取扱いを開始したテキサス・インスツルメンツ社の商品が半導体試験装置やATMなどの産業機器向けに伸ばしたことなどから、「半導体製品」の売上高は前期比8.5%の増加となりました。

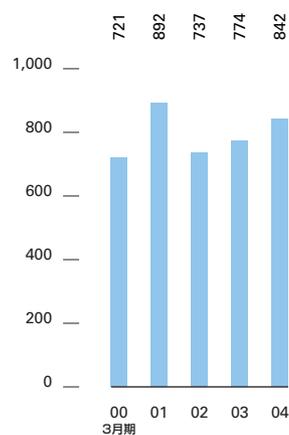
「ボード製品」については、PCマザーボード、VMEボードなど産業機器向け販売が好調であり、「ソフトウェア」については、組み込みシステム機器向けOSの拡販に努めた結果、売上が増加しました。「一般電子部品」については、パネルPC、スイッチング電源など民生機器への拡販に努めましたが、売上高は微減となりました。

また、当部門はカスタムIC、ボード、ソフトウェアの設計受託業務と自社製品の開発にも積極的に取り組んでいます。設計受託業務については、受注拡大に対応するため、2004年1月中国上海市に設計開発を行う子会社を設立しました。自社製品の開発については、液晶プロジェクター、プラズマテレビなどの映像機器向け高精度同期部分離LSIの開発やデジタルカメラ、携帯電話などに広く採用されているSDメモ리카ードのホストコントローラの開発など、

コンピュータ・ネットワーク部門売上高  
(単位：億円)



電子部品部門売上高  
(単位：億円)



市場ニーズをいち早く取り入れたLSIの開発を行いました。

今後も、顧客ニーズの把握に努め、カスタムIC、専用IC、アナログICなどの高付加価値商品の技術サポートを徹底し、設計受託業務と自社製品の開発をより一層推進していきます。

### 売上総利益、販売費および一般管理費、営業利益

売上原価は前期比19.3%増加の3,895億円、売上総利益は前期比4.6%増加の1,402億円となりました。この結果、売上総利益率は前期比2.6ポイント減少し26.5%となりました。

売上総利益率については、コストダウンおよび工場稼働率の改善が進んだものの、一部サービス子会社とのフィールドエンジニアリングに関わる契約形態の変更による影響もあり、若干の減少となりました。

販売費および一般管理費は前期比11.3%減少の1,179億円となり、売上高に対する比率は前期の28.9%から22.3%となりました。販売費および一般管理費の主な減少要因は、開発案件の選択と集中および開発期間の短縮化による研究開発費の減少と、前述の一部サービス子会社とのフィールドエンジニアリングに関わる契約形態の変更に伴う減少です。なお、研究開発費としては、新製品および65ナノメートル以降のプロセス技術・装置開発などを中

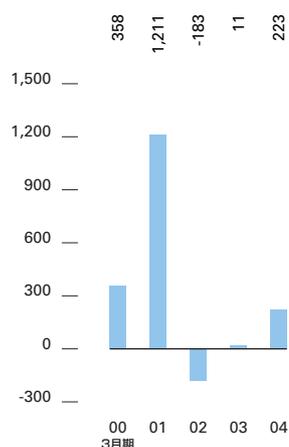
心として、前期比11.9%減少の441億円を計上しました。これらの結果、営業利益は前期の11億円から212億円増加し、223億円となりました。

### その他収益（費用）および当期純利益

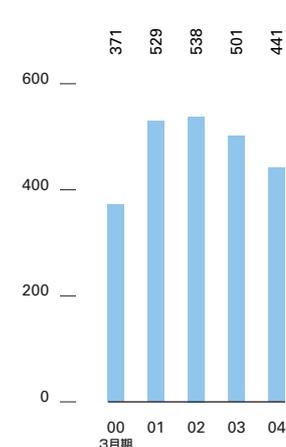
その他費用純額は、損失額が前期より168億円減少し、73億円の損失となりました。これは主に、事業構造改革の取り組みとして前期に206億円計上した特別損失が181億円減少したことによるものです。この結果、税金等調整前当期純利益は前期から379億円増加し、149億円となりました。

当期純利益は、499億円増加し83億円、1株当たり当期純利益は46.37円（前期1株当たり当期純損失238.57円）となりました。配当金は前期比2円増加の10円、配当性向は、単独ベースで47.4%となりました。

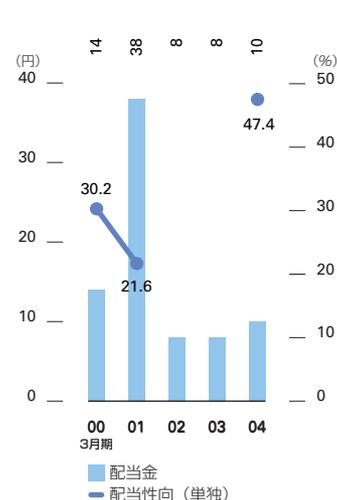
営業利益  
(単位：億円)



研究開発費  
(単位：億円)



配当金及び配当性向  
(単位：円/%)



2002年3月期及び2003年3月期の配当性向は単独ベースで当期純損失を計上したため掲載しておりません。

## 財政状態およびキャッシュ・フロー

### 財政状態

2004年3月期末の流動資産は、前期末から465億円増加し4,030億円となりました。主な内容としては、売上増加に伴い受取手形および売掛金が前期末から633億円増加し、現金および預金は運転資金の増加により103億円減少しました。また、たな卸資産は増産基調のなか工場の仕掛品が増加しましたが、製商品の販売促進に取り組んだ結果、全体では前期末から66億円減少し、1,052億円となりました。未収金を除く受取手形および売掛金の回転日数（期末時点の売上高と売掛金で計算）は売掛金の回収期間が比較的長い地域向けの売上が増加したことに伴い前期末の135日から159日となりましたが、たな卸資産回転日数は前期の89日から72日に改善しました。

有形固定資産は、前期末から108億円減少の1,088億円となりました。なお、当期の設備投資額は評価用機械装置の取得とIT関連投資を中心として、110億円となりました。

投資その他の資産は、前期末から10億円増加の499億円となりました。これは主に、株価上昇による有価証券評価額の増加によるものであります。

総資産は、前期末から367億円増加の5,616億円となりました。

流動負債は、前期末に比べ192億円減少の1,415億円となりました。これは主に、生産増加に伴う仕入の増加により買掛金が増加したものの、コマーシャル・ペーパー350億円の償還および第2回転換社債が満期を迎えたことによるものであります。

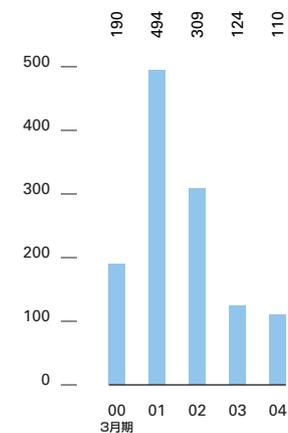
長期負債は、第10回無担保社債200億円および第11回無担保社債300億円を発行したことなどにより、前期末に比べ327億円増加の1,404億円となりました。

株主資本については、転換社債の株式への転換と当期純利益による剰余金の増加により、前期比229億円増加の2,758億円となり、株主資本比率は、前期の48.2%から49.1%に上昇しました。株主資本利益率（ROE）は3.1%になりました。

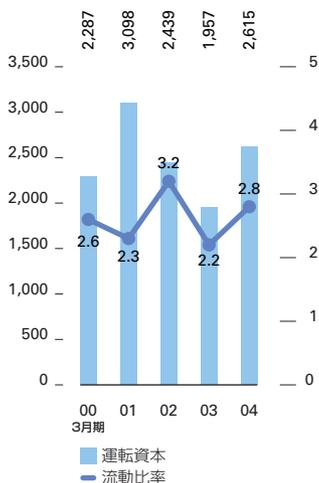
### キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の214億円のプラスに対し、79億円のプラスと減少しました。当期の主な内訳は、税金等調整前当期純利益149億円、減価償却費250億円および仕入債務の増加292億円がそれぞれキャッシュ・フローのプラス要因となった一方、売上増加

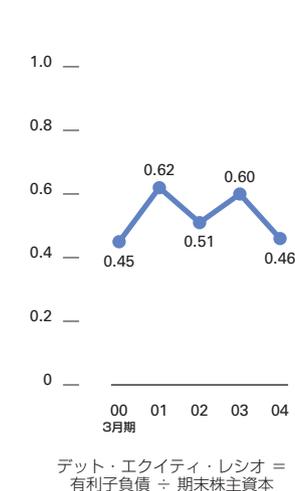
設備投資額  
(単位：億円)



運転資本及び流動比率  
(単位：億円/倍)



デット・エクイティ・レシオ  
(単位：倍)



に伴う売上債権の増加により618億円がマイナス要因となったことによります。

投資活動によるキャッシュ・フローには、前期のマイナス73億円に対してマイナス85億円となりました。研究開発用機械装置の取得による75億円がその主な内容です。

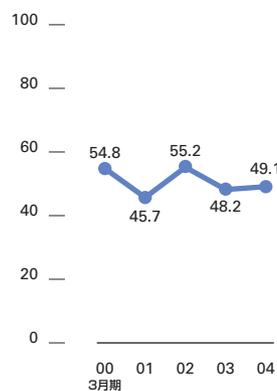
財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーおよび第8回無担保社債の償還、借入金の返済、配当金の支払などの支出がありましたが、第10回無担保社

債200億円および第11回無担保社債300億円の発行による調達などの結果、前期のマイナス99億円から当期はマイナス103億円となりました。

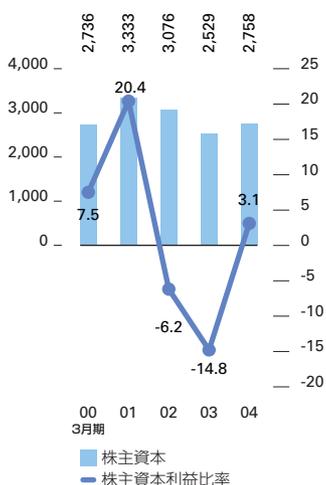
現金および現金同等物の期末残高は、前期末の530億円から103億円減少の427億円となりました。

	単位：百万円（総資産に占める割合）		単位：千米ドル	
	2004年	2003年	2004年	
資産合計	¥561,632 (100.0)	¥524,901 (100.0)	\$5,316,467	
現金及び預金	42,650 (7.6)	52,982 (10.1)	403,727	
受取手形及び売掛金	245,554 (43.7)	182,218 (34.7)	2,324,439	
たな卸資産	105,187 (18.7)	111,810 (21.3)	995,712	
投資その他の資産	49,869 (8.9)	48,851 (9.3)	472,064	
有形固定資産	108,789 (19.4)	119,611 (22.8)	1,029,805	
負債合計	281,885 (50.2)	268,402 (51.1)	2,668,356	
短期借入金	6,815 (1.2)	8,729 (1.7)	64,514	
支払手形及び買掛金	78,009 (13.9)	48,279 (9.2)	738,440	
未払法人税等	3,273 (0.6)	3,645 (0.7)	30,983	
長期借入金及び社債	98,476 (17.5)	70,230 (13.4)	932,181	
株主資本	275,800 (49.1)	252,904 (48.2)	2,610,748	

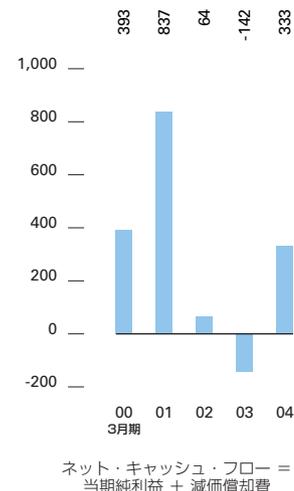
### 株主資本比率 (単位：%)



### 株主資本及び株主資本利益率 (ROE) (単位：億円/%)



### ネット・キャッシュ・フロー (単位：億円)



## 事業等のリスク

当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがあります。

### (1) 外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっています。当社の輸出は為替リスクを回避するために円建て取引にて行うことを原則としていますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約等によって為替リスクヘッジに努めています。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社の業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (2) 研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術等の最先端技術について積極的な研究開発投資および研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって、当社が参入する各製品分野において高い市場シェアと利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれ等の影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (3) 半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置等のハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加等の発生により当社業績およびキャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性があります。

### (4) 特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品および顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メー

カーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上高が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (5) 品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を新製品に搭載し早期に市場へ投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、およびレベルの高いサービス体制の確立にも努め、それらの結果、当社の製品を多くの顧客に採用してもらうことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品である等の原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品が発生する等により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (6) 知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略および知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、当社の製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や知的財産権を回避する場合等があるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (7) その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業におけるさらなる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、リスク管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社および他業種企業と同様に、世界および各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症等の不可抗力、金融・株式市場、政府等による規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失等の影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。